



YAMAHA

TRUSTED TECHNOLOGY



NOUVEAU

YSi-SP

SMT Innovation

Machine d'inspection de la pâte à braser en 3D

Une solution à 1 tête pour différentes inspections

Inspections haute précision haute cadence

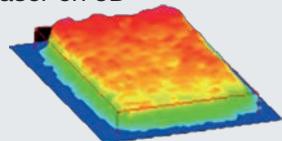
Une solution M2M complète en complément de la Yamaha True Total Line Solution

Une fonction d'inspection de la pâte à braser compatible avec de multiples analyses

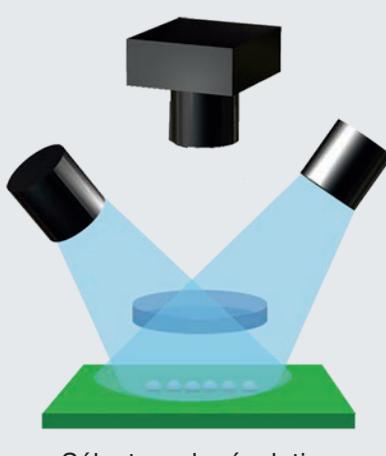
**CARACTÉRISTIQUE 1****Une « solution à 1 tête » pour réaliser différentes inspections**

Un seul type de tête compatible avec toutes sortes d'inspections, ce qui réduit les temps de cycle et les coûts de configuration tout en augmentant votre productivité.

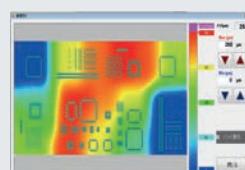
Inspection de la pâte à braser en 3D



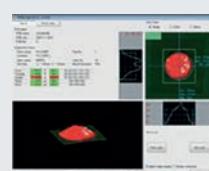
Inspection des matières étrangères (option)



Affichage du flambage des cartes



Inspection du bonding en 3D (option)

**CARACTÉRISTIQUE 2****Des inspections haute précision et haute cadence grâce à l'inspection en 3D + 2D, aux différentes résolutions d'image et bien plus****■ Des inspections en 3D ultra-précises au moyen d'un simple algorithme en 3 étapes**

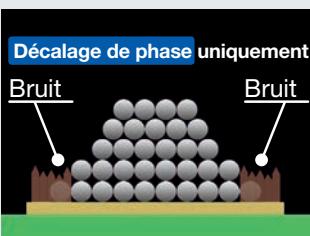
- Réglage de la mise au point
 - Réglage de la mise au point
 - Réglage de la mise au point
-
- La hauteur de la caméra corrige automatiquement le réglage de la mise au point pour suivre le flambage des cartes jusqu'à ± 5 mm.
- Mesurez la superficie en extrayant précisément le contour de la pâte à braser grâce à l'éclairage circulaire en 2D.

■ Extraction haute précision du contour en 2D

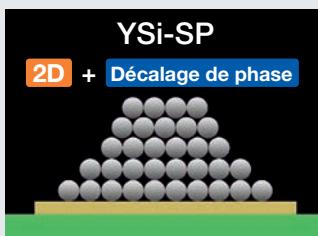
Pour reproduire les formes exactes en combinaison avec la méthode du décalage de phase.

■ Pour des inspections haute cadence et haute résolution à l'aide d'une seule et même unité !

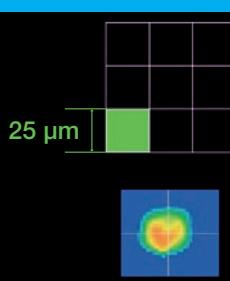
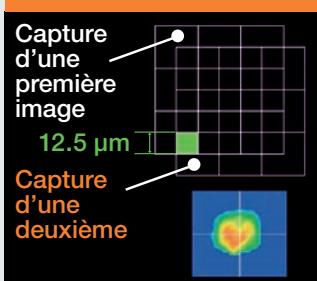
La technologie très haute résolution propose une résolution ajustable pour chaque champ de vision.



Il est difficile de reproduire des formes précises en raison du bruit.



Offre une grande reproductibilité pour l'extraction des contours par inspection en 2D.

Mode standard**Mode haute résolution**

CARACTÉRISTIQUE 3**Une solution machine-machine (M2M)
poussée et complète**

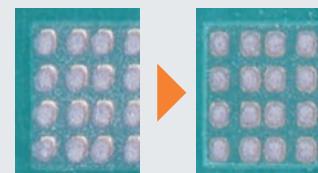
La marque Yamaha peut fournir tous les principaux équipements nécessaires au montage des composants sur un ensemble électronique. Le lien entre la machine d'inspection et chaque équipement crée une ligne de production dont la qualité et la productivité sont supérieures.

- Changements de configuration automatiques**

Les paramètres, tels que les données de cartes de la ligne de fabrication et la largeur du convoyeur, sont régulièrement envoyés depuis les unités en amont en scannant les identifiants comme les codes-barres des cartes et des fiches d'instruction afin de réduire automatiquement le temps nécessaire aux changements de configuration et de produits.

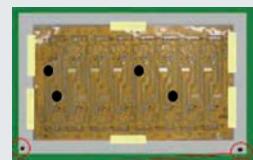
- Informations de sérigraphie en retour**

Les informations de sérigraphie en retour et les instructions de nettoyage fournies par la machine d'inspection à la machine de sérigraphie située en aval garantissent une sérigraphie de grande qualité.



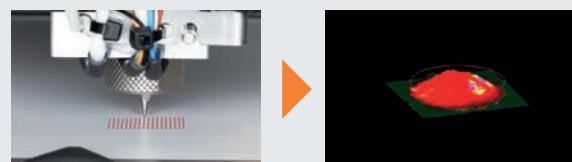
- Transmission des décalages de mires**

Lorsque l'YSi-SP identifie un décalage de mire sur la carte, elle envoie l'information à la machine de placement située en aval pour éviter les défauts redondants et raccourcir les temps de cycle.

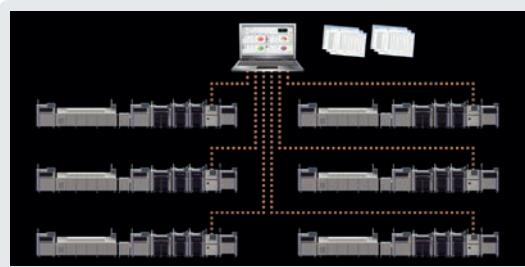


- Conversion automatique des données
d'inspection du revêtement**

Envoyez les données de revêtement de la machine de dépôse à la machine d'inspection d'un simple clic !

**CARACTÉRISTIQUE 4****La maîtrise statistique des procédés (MSP)
pour diverses analyses statistiques**

Elle enregistre toutes les images et données de mesure tampons, calcule des statistiques et analyse les trous et les fentes grâce à de multiples méthodes. Le logiciel d'un PC peut se connecter avec 6 machines d'inspection.

**CARACTÉRISTIQUE 5****Des options pour le traitement de différents produits**

Une large gamme d'options permettent une compatibilité avec une grande variété de lignes de production grâce à la très haute résolution, pour inspecter la pâte à braser sur de toutes petites pièces comme les boîtiers 0201 (0,25 mm x 0,125 mm) ou les puces 03015 (0,3 mm x 0,15 mm) ; l'inspection du bonding pour contrôler l'état du revêtement adhésif des machines de dépôse ; l'inspection des matières étrangères pour détecter toute substance étrangère sur la carte ; et d'autres options adaptables à différentes lignes de production.



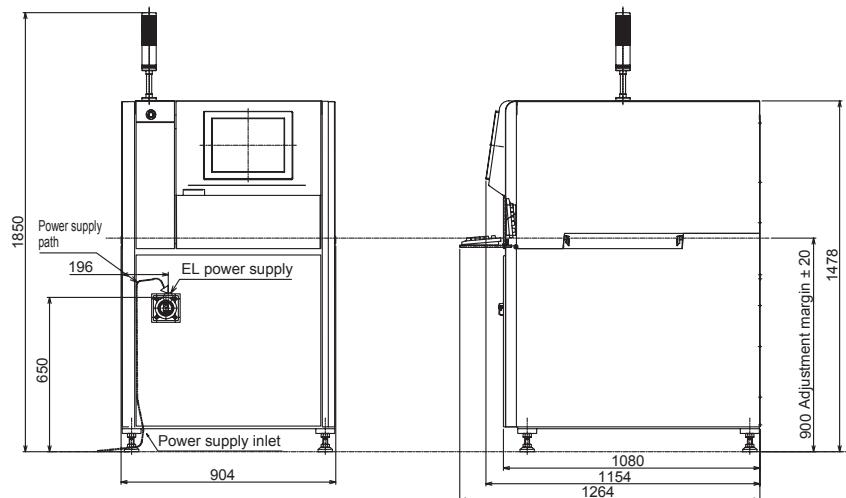
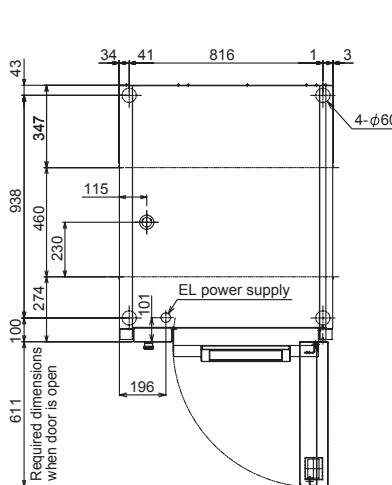
Caractéristiques

Tailles de cartes compatible
Résolution horizontale (champ de vision)
Vitesse d'inspection
Résolution 25 (12,5) µm
Résolution 20 (10) µm
Résolution 15 (7,5) µm
Volume de précision 3 σ
Résolution verticale
Éléments d'inspection
Alimentation électrique
Source d'alimentation en air
Dimensions extérieures
Poids

YSi-SP

L 510 mm x I 460 mm à L 50 mm x I 50 mm (single lane) Épaisseur 0,3 à 5,0 mm
1) 25 µm / 12.5 µm (environ 50 x 50 mm) 2) 20 µm / 10 µm (environ 40 x 40 mm) 3) 15 µm / 7.5 µm (environ 30 x 30 mm) * Il s'agit de types de sélection standards.
Double projecteur
Simple projecteur
Standard (haute résolution)
Standard (haute résolution)
8900 (5 600) mm ² /s
9 400 (6 000) mm ² /s
5 700 (3 500) mm ² /s
6 000 (3 700) mm ² /s
3 200 (1 900) mm ² /s
3 300 (2 000) mm ² /s
±2 %
±3 %
1 µm
Qualité de la pâte à braser (volume, hauteur, emplacement, alignement)
CA monophasé 200/208/220/230/240 V ±10%
Sans air
L 904 mm x I 1 080 mm x H 1 478 mm
Environ 550 kg

*Les caractéristiques et l'aspect du produit sont sujets à modifications sans préavis.



Yamaha Motor Europe N.V.
Niederlassung Deutschland, Geschäftsbereich IM
German Branch Office, IM Business
Hansemannstrasse 12 · 41468 Neuss · Allemagne
Tél. : +49-2131-2013520
info-ymeim@yamaha-motor.de
www.yamaha-motor-im.eu